



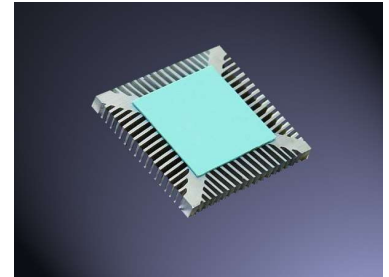
ZH非硅导热垫片-ZH Thermal PAD

技术数据表 Technical Data Sheet



产品描述

非硅导热垫片是无硅氧烷分子析出的导热垫片，是针对硅油敏感场合开发的一种高导热、高强度、阻燃的界面导热片材，传统有硅导热垫片受热、受压后都会有硅油成份渗出，为了解决硅油析出污染使用场景下的需求，针对不同应用场合开发了多个型号，可以满足高压压缩、多次重工、抗撕裂、高频振动冲击等多种应用场合。



Typical Applications :

- 汽车电子 (ECU's) •
- 移动及通讯设备
- 可控硅
- 微处理器/图形处理器
- 光学精密设备

Features/Benefits :

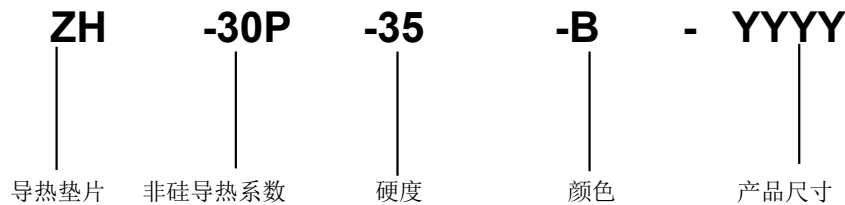
- 良好电绝缘性
- 无硅油成份
- 高压压缩率
- 证明长期的可靠性
- 高导热能力

典型性能		非硅导热垫片					测试方法
		ZH-10P	ZH-15P	ZH-20P	ZH-30P	单位	
物理性能	颜色	白色	灰色	粉红色	浅兰		目测
	厚度	0.5-5	0.5-5	0.5-5	0.5-5	mm	ASTM-D374
	密度	1.7	2.5	2.7	3.1	g/cm ³	ASTM-D792
	硬度	35	35	35	35	Shore C	ASTM-D2240
	延伸率	<290	150	<110	<80	%	ASTM-D412
	抗撕裂强度	≥600	≥600	≥600	≥600	N/M	ASTM-D412
	重量损失	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	%	EN-344
热性能	导热系数	1.0	1.5	2.0	3.0	W/m.k	ASTM D5470
	有效工作温度	-30~150	-30~150	-30~150	-30~150	°C	EN-344
电性能	抗击穿电压	>8	>8	>8	>5	ASTM-D149	ASTM D149
	体积电阻	>10 ¹²	>10 ¹²	>10 ¹²	>10 ¹²	ASTM-D247	ASTM D257
常规性能	阻燃等级	V0	V0	V0	V0	UL-94	Zesion
	RoHS	YES	YES	YES	YES		SGS
	保质期	18	18	18	18	months	Zesion

(continued on next page)

导热硅胶标准规格为200*400或300*300（长*宽，单位mm），厚度为0.3-10mm

可以使用下面的料号进行物料信息识别



示例

ZH10P35B2525010 = 导热系数1.0W硬度35度黑色25*25*1.0非硅导热垫片

ZH20P30BL8080035 = 导热系数2.0W硬度30度兰色80*80*3.5非硅导热垫片

ZH30P45G6060025 = 导热系数3.0W硬度45度灰色60*60*2.5非硅导热垫片

This information and our technical advise – whether verbal, in writing or by way of trials – are given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. Our advice does not release you from the obligation to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended processes and uses. The application, use and processing of our products and the products manufactured by you on the basis of our technical advice are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sale and Delivery.